

次世代高性能HPCへの取り組み

スーパーコンピュータ、5Gインフラ、HPC向け基板など
超高速伝送を実現する基板ソリューションをご提供

高周波領域での安定的な高速伝送の実現



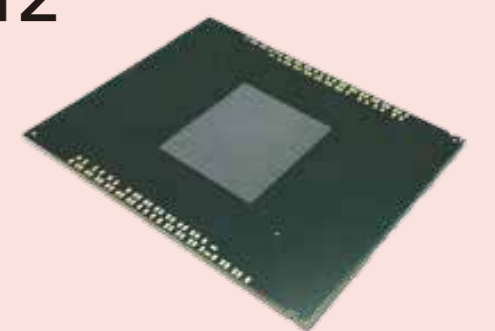
■ 薄膜キャパシタ内蔵 半導体パッケージ基板

- 低インダクタンスのキャパシタをLSI直下に
- 高周波領域の電源ノイズを低減
- 高速CPUの高周波での安定動作を実現

富士通株式会社 UnixサーバM12
「SPARC64™ XII」が採用

電源インピーダンス 77%減
電源ノイズ 50%減

動作周波数4GHzの壁を超える

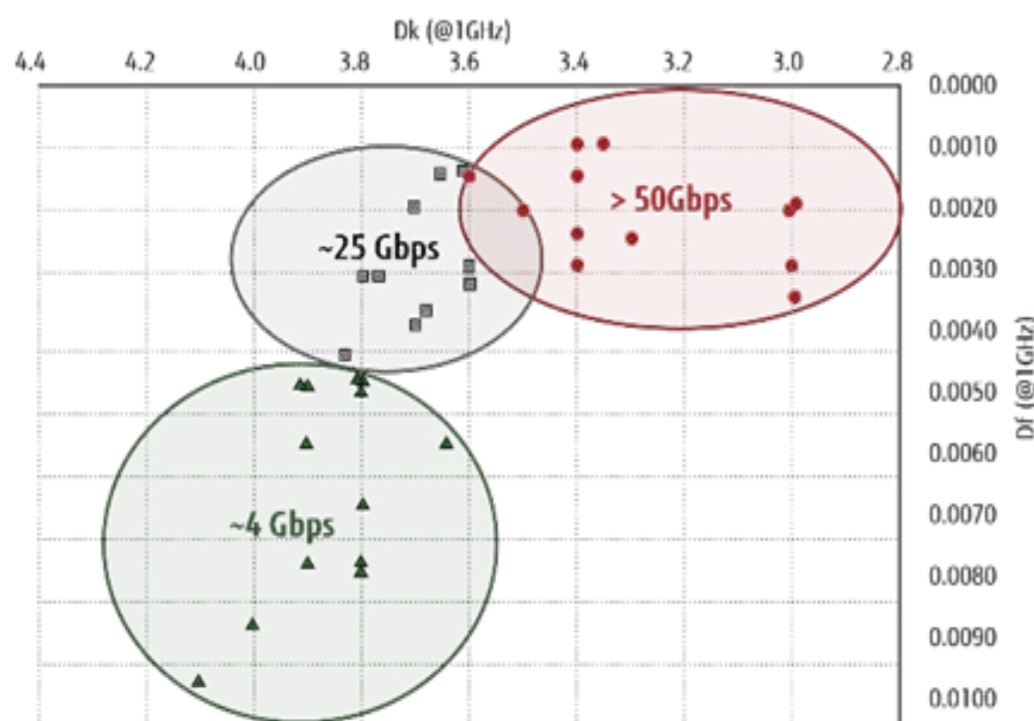


■ 伝送損失低減への取り組み

低誘電材料

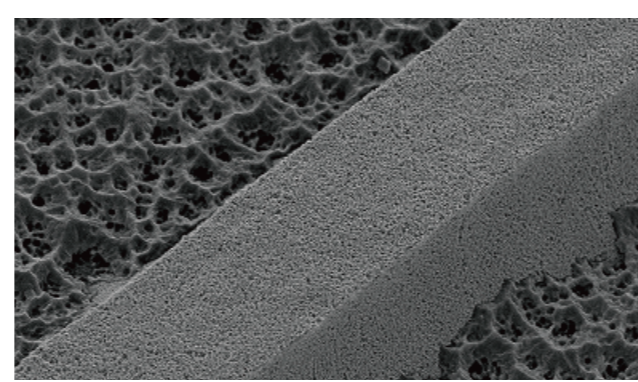
Material

低誘電材料と導体表面平坦化で
50Gbpsを実現

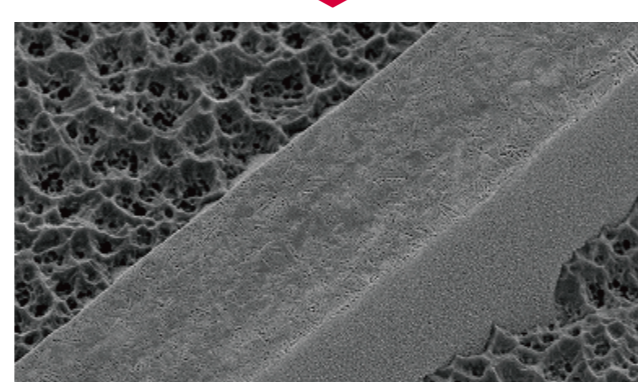


表面の平坦化

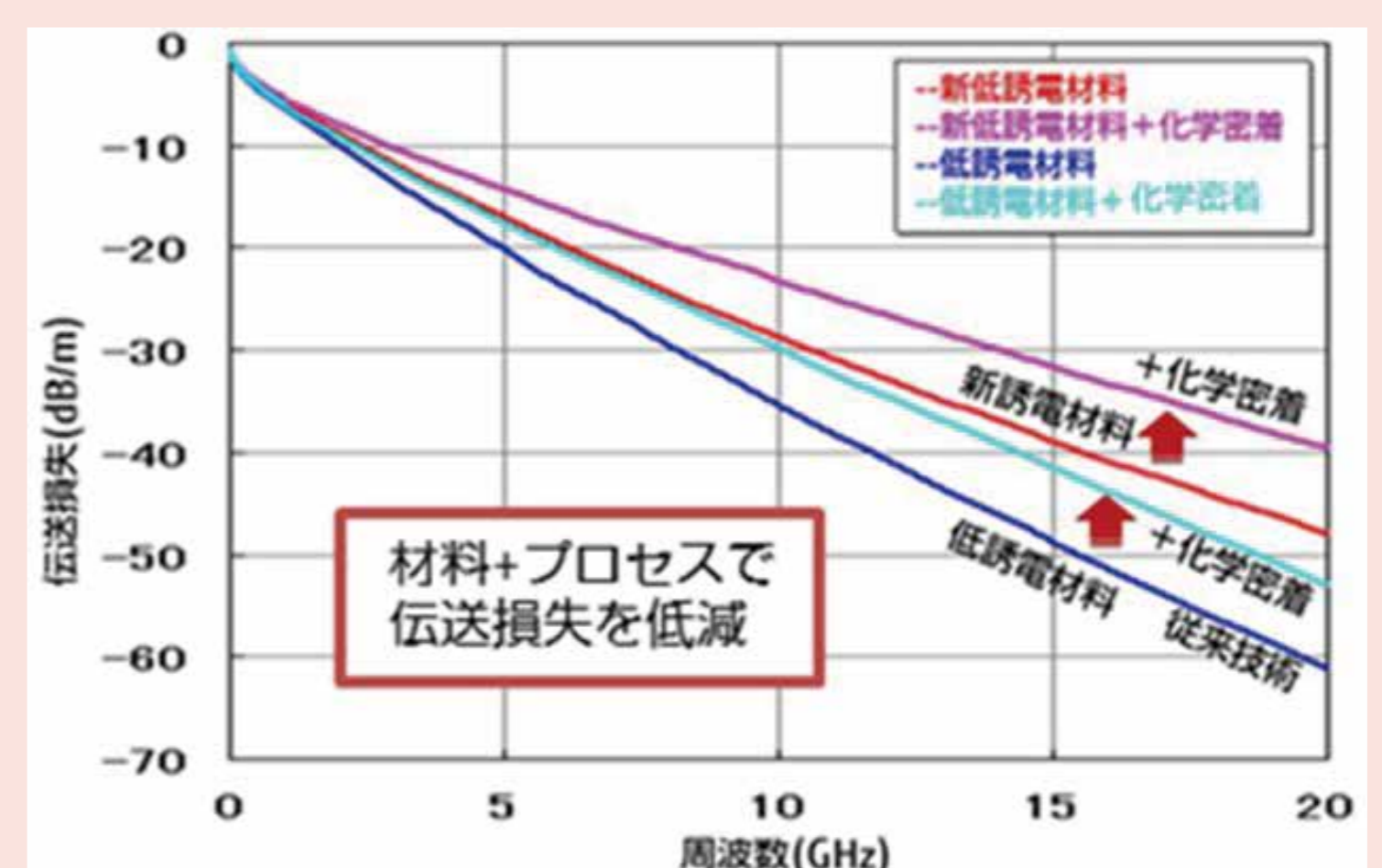
Process



従来技術



化学密着

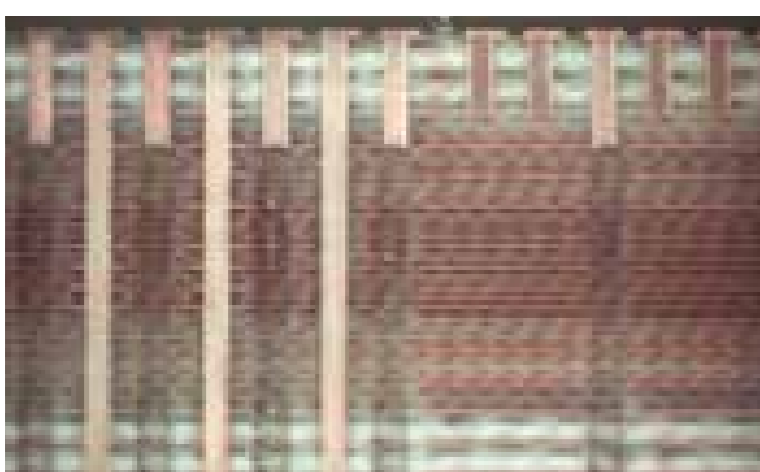


トータルで伝送損失を低減

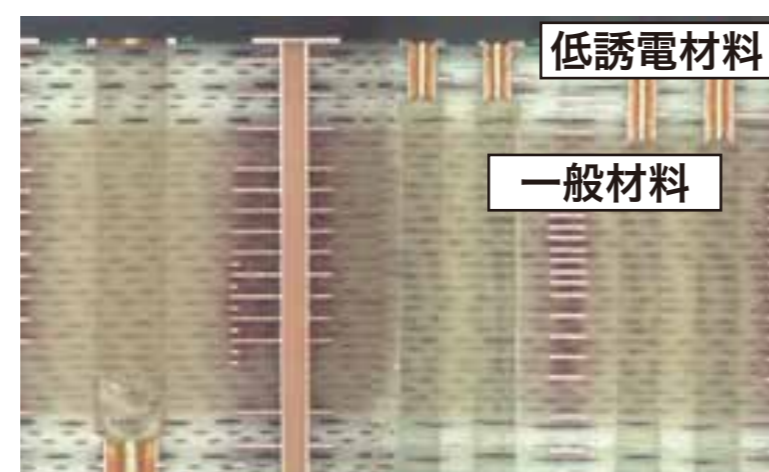
■ 次世代HPC性能向上への更なる取り組み

従来スタブレス構造

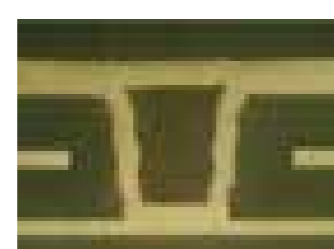
Structure



バックドリル工法

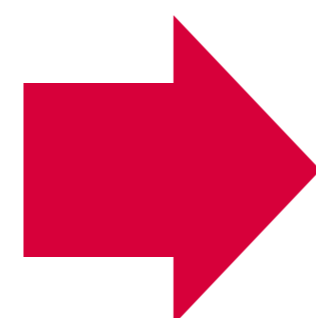


異種材料複合技術

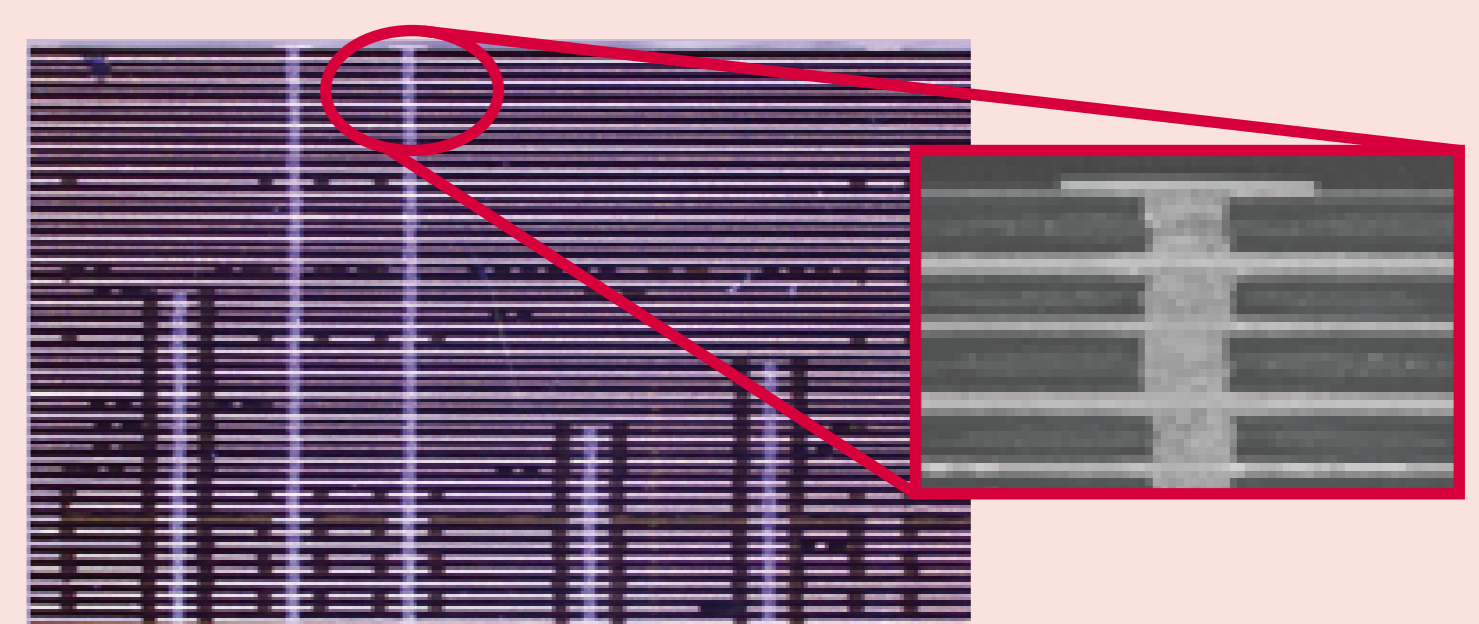


スキップビア

究極の
全層IVHを
実現



全層IVH F-ALCS (エフアルシス) 技術



不要スタブ“ゼロ”で飛躍的配線収容と
高速伝送特性の向上

